

[IV~23]

Pt/MgO(100) 기판상에 In-situ 성장된 (Pb,La)TiO₃ 박막의 전기적 특성 (Electrical Properties of the In-situ Grown (Pb,La)TiO₃ Films on the Pt/MgO(100))

이상열, 김민영, 장호정, 장지근
단국대학교 전자공학과

요약

적외선 센서의 재료로 활용되고 있는 PLT 박막(두께 : 8000~9000 Å)을 Pt/MgO(100)의 하부 구조상에 500 °C, 550 °C 및 600 °C에서 스퍼터링 증착하여 결정성 및 전기적 특성을 조사하였다. 600 °C로 in-situ 성장된 PLT 박막은 c-축(00l) 방향으로 배향 성장되었고, 비유전상수(ϵ_r)와 유전정접($\tan \delta$)의 값이 10kHz~100kHz의 주파수에서 $\epsilon_r \approx 35$ 와 $\tan \delta \approx 0.01$ 로 나타났다. 잔류분극량(2Pr)과 초전계수(γ)는 상온부근에서 $2Pr \approx 5 \mu C/cm^2$, $\gamma \approx 4 \times 10^{-8} C/cm^2 \cdot ^\circ C$ 로 비교적 양호한 초전박막의 전기적 특성을 나타내었다.

실험방법

MgO(100) 단결정 기판위에 DC 스퍼터링 방식(Ar+O₂(10%) : 3×10^{-2} Torr)으로 약 1600 Å 두께의 Pt 박막을 증착하고 하부전극의 결정성 개선을 위해 650 °C의 온도에서 1분간 RTA 방식으로 후속 열처리를 실시하였다. 초전박막의 제작과정에서는 (Pb_{0.9}La_{0.1})Ti_{0.98}O₃+PbO(20mole%)의 조성을 갖는 스퍼터링 타겟을 사용하여 RF magnetron sputtering 방식(Ar+O₂(10%): 6×10^{-2} Torr)으로 500 °C, 550 °C 및 600 °C의 온도에서 약 8000 Å~9000 Å 두께의 PLT 박막을 증착하였다. In-situ 성장 방법으로 얻어진 PLT 초전박막에 대해 결정상의 변화 과정을 조사하기 위해 X선 회절 분석을 하였으며, SEM/TEM을 이용하여 표면 및 단면 형상을 관찰하였다. 이후, 전기적 특성을 측정하기 위해 열진공 증착법(진공도 : 약 1×10^{-6} Torr)으로 PLT 박막위에 직경 0.2mm 크기의 Al-상부전극을 형성하고 HP-4145B, HP-4192A, 및 RT 66A 장비를 이용하여 상온에서 잔류-전압 특성, 주파수에 따른 비유전상수(ϵ_r) 및 유전정접($\tan \delta$), P-E 이력 특성(P-E hysteresis loops)을 측정하였으며 20 °C/min의 온도 변화에서 Byer-Roundy 방법으로 초전계수(γ)를 측정하였다.

결론

- (1) 550 °C 이하에서 in-situ 성장된 PLT 박막의 경우 randomly oriented perovskite 결정구조를 나타내었으며 600 °C로 in-situ 성장된 PLT 박막은 분극축인 c축<(001)> 방향으로 배향 성장된 결정구조를 나타내었다.
- (2) 600 °C에서 in-situ 성장된 PLT 박막의 경우 10kHz~100kHz 주파수에서 비유전상수(ϵ_r)와 $\tan \delta$ 는 약 35와 0.01로 각각 나타났다. 또한 잔류분극(2Pr)의 값과 초전계수(γ)는 상온부근에서 약 $5 \mu C/cm^2$ 와 $4 \times 10^{-8} C/cm^2 \cdot ^\circ C$ 로 비교적 양호한 초전박막의 전기적 특성을 나타내었다. Pt/MgO(100) 기판위에 600 °C로 in-situ 성장된 PLT 박막이 높은 초전계수를 갖는 것은 분극축인 c축으로 배향 성장된 결정구조를 갖기 때문이다.
- (3) SEM 사진을 통해 표면 형상을 관찰해본 결과 증착 온도가 증가함에 따라 결정립의 크기가 커지고 표면 상태가 치밀하게 구성되지 못함을 살펴볼 수 있었다. 600 °C에서 in-situ 성장된 시료의 PLT 박막 표면에는 0.5 μm~1.0 μm 크기의 cluster가 발견되었다. cluster가 박막 표면에 존재하는 것은 박막 증착 시 높은 증착 압력에 의해 target 내 원소 성분의 증발이 불안정하게 되고 고온에서 thermal stress가 발생하여 균일한 막이 형성되지 못한 것으로 생각된다.
- (4) TEM 및 SNMS profile을 분석한 결과 하부전극과 PLT 간의 계면 형상이 매우 평활하게 나타나고 있음을 볼 수 있었으며 PLT 박막 내의 조성이 깊이에 따라 비교적 균일하게 분포되어 있고, Pt층과 PLT층은 상호 반응 없이 비교적 안정된 막을 형성하고 있음을 볼 수 있었다.

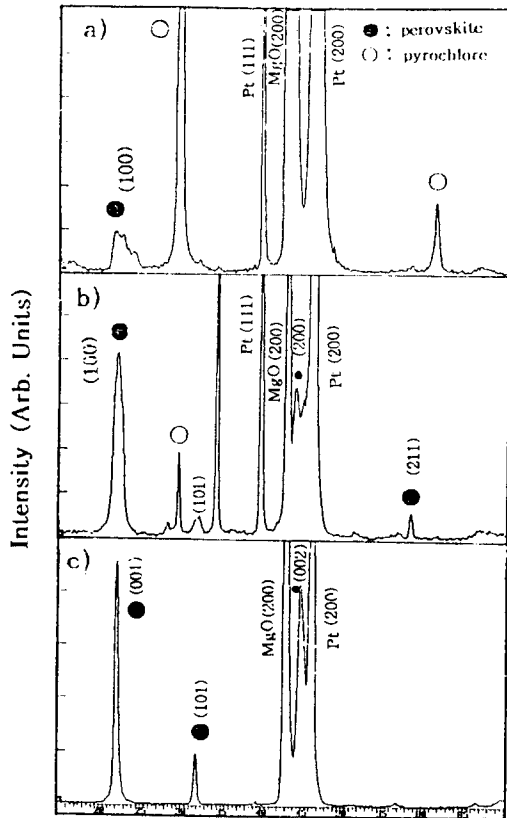


Fig.1. XRD patterns of the PLT films deposited at a) 500°C b) 550°C and c) 600°C.

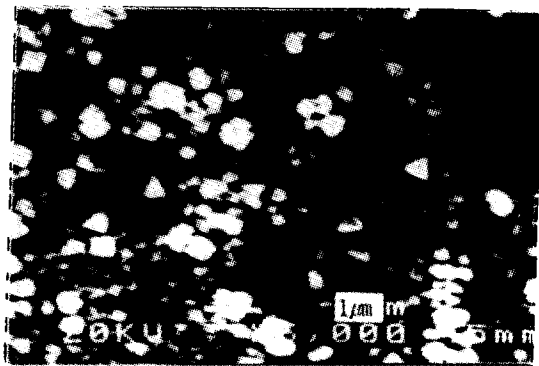


Fig. 2. SEM surfacial micrograph of the PLT film deposited at 600°C.

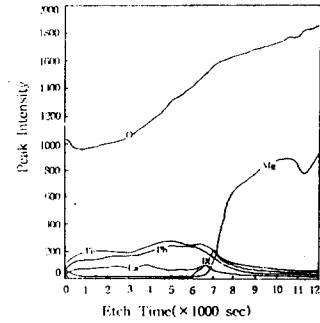


Fig. 3. SNMS depth profile of the PLT film deposited at 600°C.

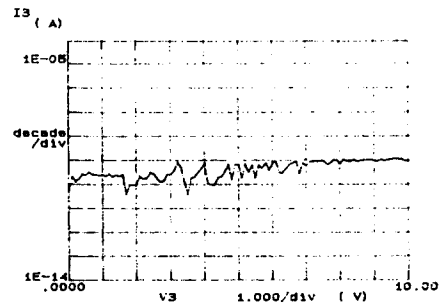


Fig. 4. I-V characteristics of the PLT film deposited at 600°C.

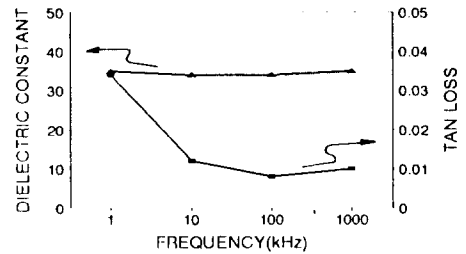


Fig. 5. Dielectric constant (ϵ_r) and $\tan \delta$ of the PLT film deposited at 600°C.

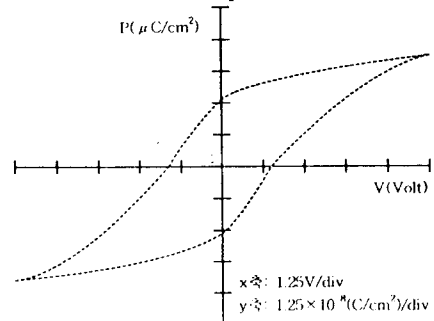


Fig. 6. P-E hysteresis loop of the PLT film deposited at 600°C.